

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2026-041

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

为满足公司及子公司生产经营目标及发展需要，现计划以流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理、项目贷款以及其他方式，公司及子公司拟向银行申请最高额不超过113亿元人民币及3.2亿元新台币的综合授信额度，以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度有效期自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止，在授权期限内可循环使用。公司董事会授权公司董事长彭骞先生，办理上述综合授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

上述银行综合授信事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准后方可实施。

#### 备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日